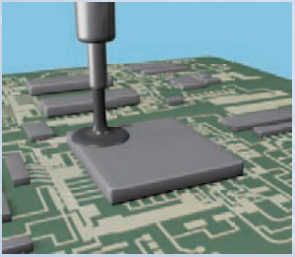
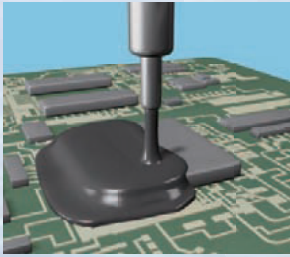


ドロップコーティング

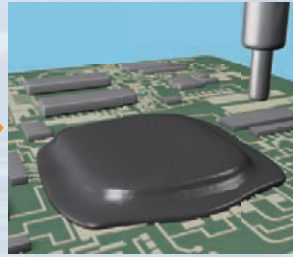
基板に実装されたデバイスに直接塗布する封止樹脂



実装基板



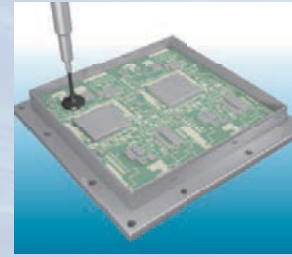
コーティング(走査)



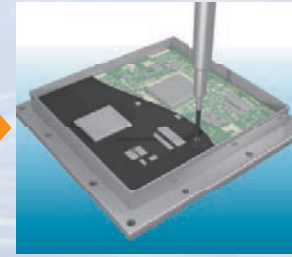
加熱硬化

ポッティング(1液タイプ)

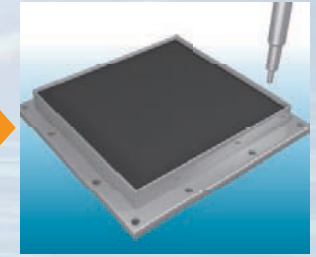
エンブラなどの枠材を備えたモジュールやセンサーなどの基板に注入する封止樹脂



枠付き実装基板



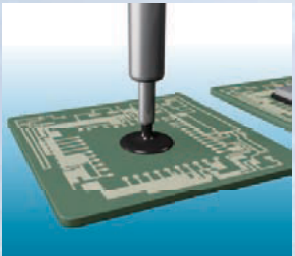
ポッティング



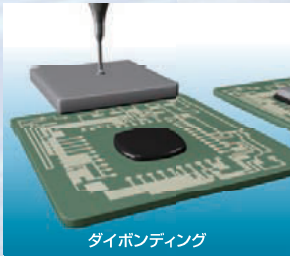
加熱硬化

ダイボンディング

基板と半導体チップを装着する非導電タイプの接着剤

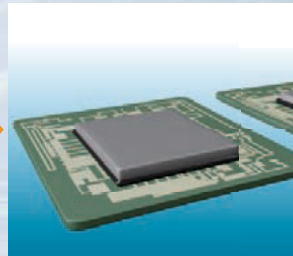


塗布



ダイボンディング

半導体チップ取付



半導体チップ装着

加熱硬化

ポッティング(2液タイプ)

使用直前に主剤と硬化剤を混合して注入する封止樹脂



2液(定量)吐出



2液混合



ポッティング

加熱硬化